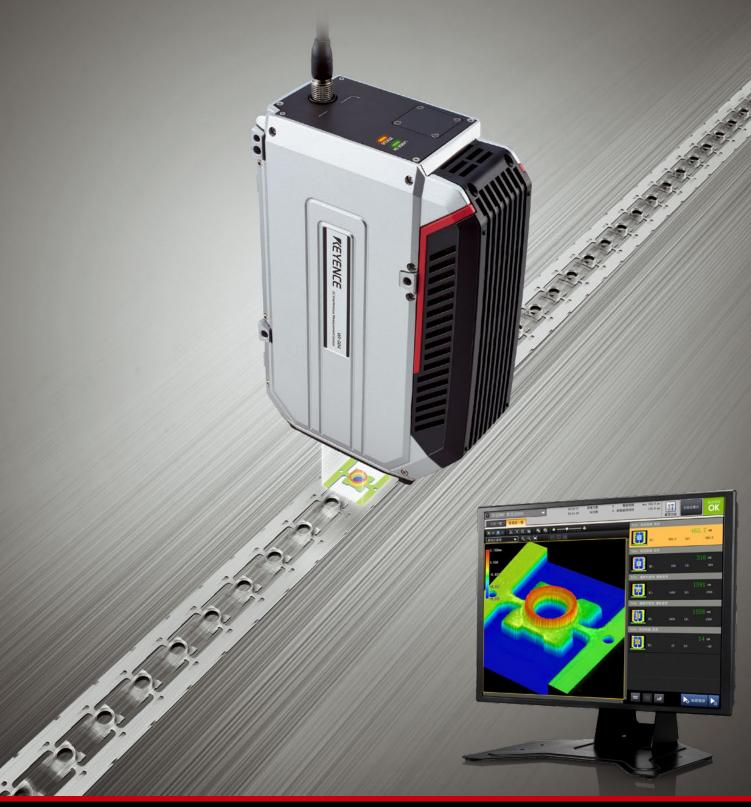
KEYENCE

高精度地「瞬間3D」量測



8 萬個點的高度, 只要 0.13 秒即可高精度量測



掌握「最真實的形狀」的量測能力

針對最大 $10 \times 10 \text{ mm}$ 的量測區域,瞬間取得 8 萬點的高度資料。由於採用白光干涉原理,即使同時存在因顏色或材質導致反射率不同的目標物,仍可實現正確的形狀量測。

2 於線上實現高速全數檢查

為了在線上使用而追求高速性。即便有 8 萬點的大量量測資料,仍可透過獨家開發系統,實現最快 0.13 秒的高速取樣。

3 大幅減少離線檢查工時

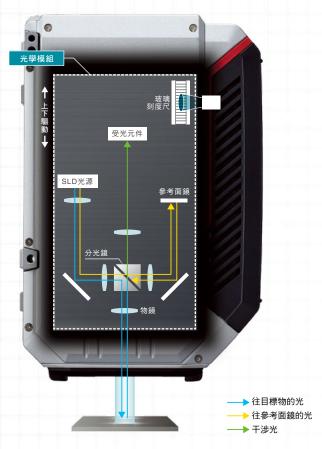
將感測頭固定於專用支架上,即可用於離線檢查。還搭載了可減少檢查工時的各種實用功能。改善從簡易量測到資料儲存等各種場合的操作性。



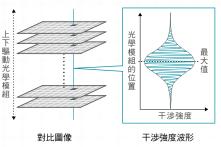
3

掌握「最真實的形狀」的量測能力

採用白光干涉原理實現高精度量測



自光源照射的光會受到分光鏡分為兩道,一 道會受到目標物反射,另一道則會受到參考 面鏡反射,成為干涉光進入受光元件。干涉 光的干涉強度在彼此的光徑長一致時為最大。 上下驅動將所有光學零件組裝成一體的光學 模組,並從獲得的多張對比圖像,針對每個 畫素讀取干涉強度最大時的光學模組位置, 藉此量測與目標物之間的距離。



可視用途選擇的感測頭種類

提供可視用途選擇的 3 種感測頭,從節距 $4 \mu m$ 的高度精細形狀量測,到 $10 \times 10 m m$ 的同時高精度量測均可使用。

	高度精細型 WI-001	標準型 WI-004	大視野型 WI-010
量測範圍			
	1 × 1 mm	4 × 4 mm	10 × 10 mm
最小檢測區域	4 × 4 μm	15 × 15 μm	40 × 40 μm
高度測量範圍	1.4 mm(標準模式) [,] 0.7 mm(高速模式)		
重複精度(段差)	0.1 µm		

壓倒性的因應能力與穩定性

目標物材質或顏色差異導致的偏移、死角導致的無法量測區域會成為正確形狀量測的阻礙。針對這些課題,就由白 光干涉原理解決。

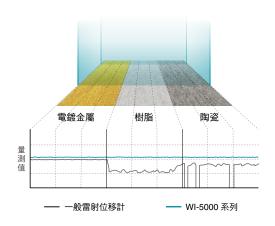
不受材質、顏色影響

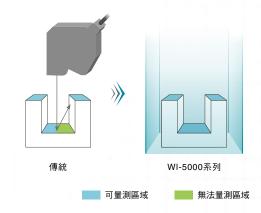
實現寬廣光量動態量程的 WI-5000 系列,一次拍攝即可同時量測電鍍金屬(反射光大)乃至陶瓷(反射光小)。

即使量測的是如樹脂等的半透明物體,也不會受到內部反射影響,可以掌握正確的形狀。

不受死角影響

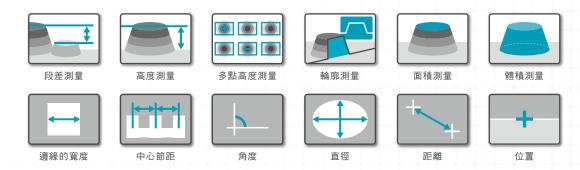
傳統的三角測距方式在量測有深度的目標物時,有時會因為反射光受到遮蔽而使量測變得困難。如果使用 WI-5000 系列,由於它採用同軸量測,因此不會產生死角導致的無法量測區域。





可實現各種量測的豐富量測模式

準備了豐富的量測模式,從利用段差/體積測量等高度資料的量測,到利用寬度/面積測量等平面資料的量測均可 廣泛因應。

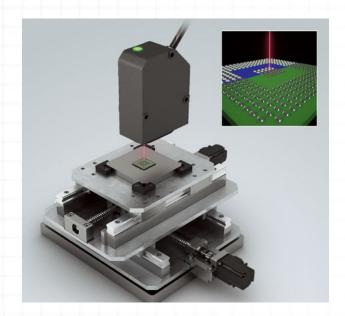


於線上實現高速全數檢查

並非以「點」,而是以「面」來量測,將抽樣檢查改為全數檢查

傳統

1D 位移計 + 驅動載物台



欲量測多點時,必須高精度且高速地掃描目標物。因此往往會將時間耗費在移動載物台上, 難以執行全數檢查。此外,建立系統的所需的 費用也相當昂貴,將其裝置化的難度較高也是 課題之一。

傳統做法:

- 需要高精度的驅動載物台
- 需要嚴密的定位控制機構
- 編程處理軟體
 - → 裝置化的難度高

▋多點量測流程





WI-5000 系列

不需驅動載物台



以面執行同時量測,不需高精度的驅動載物台。 在裝置化變容易的同時,也大幅縮短了量測時 間,因此可以執行全數檢查。

只要使用 WI-5000 系列…

- 不需高精度的驅動載物台
 - → 區域同時量測
- 不需嚴密的定位
- → 搭載位置補正功能
- 豐富的量測功能合而為一
 - → 無需程式即可立即量測

多點量測流程

放入工件時即瞬間

量測時間大幅縮短

- 檢查時間 →

實現高速區域量測的獨家開發系統

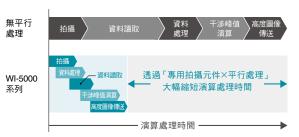
實現以「面」執行高速量測

專用拍攝元件 × IPO-Engine ◆

*「IPO」=Interference Parallel Operation,干涉平行處理

採用在高速拍攝後便於元件中執行超高速資料處理的專用拍攝元件。此外還新開發了以超高速執行拍攝資料讀取、干涉 峰值演算、高度圖像傳送的平行處理引擎。

大幅縮短傳統耗時的高精度干涉演算處理,藉此實現8萬點 高度資料的同時量測。



解決針對耐久性與 制震性的課題的技術

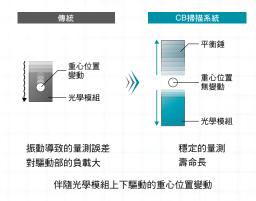
CB 掃描系統 ◆

*「CB」=Counter Balanced,平衡

開發了將 Z 軸掃描時產生的振動降低至極限的機械結構。在 掃描驅動光學部時,將相同重量的砝碼(平衡錘)往光學模組 的反方向移動,以消除感測頭內部的重心移動。

藉此,在執行高速掃描時仍可穩定量測,讓它雖然身為掃描型干涉儀,卻又同時具備可嵌入各種製造裝置的感測頭尺寸。





大幅減少離線檢查工時

只需放置即可「瞬間 3D」量測,還可消除人為誤差

傳統

使用工具顯微鏡執行檢查



由於工具顯微鏡的載物台 XY 移動與對焦的上下 滑動均以手動執行,故課題為耗費於檢查的工 時。

此外,人為量測誤差也是課題之一。

傳統做法…

- · 以手動的方式將載物台 XY 移動
- 以目視上下滑動對焦
 - → 不只耗費工時,還會產生量測誤差

▋段差測量流程



WI-5000 系列

專用支架



為了在離線檢查使用,準備了固定感測頭的專 用支架。只要使用位置補正功能,就不必執行 麻煩的定位,實現了只需放置的檢查。在大幅 減少檢查工時的同時,還可消除人為誤差。

只要使用 WI-5000 系列…

- 不需嚴密的定位
- → 大幅減少檢查工時
- → 無人為誤差

■段差測量流程

設置工件時

檢查工時大幅縮短

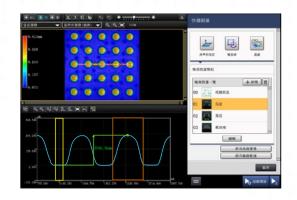
- 檢查時間 →

搭載可因應場合使用的各種便利功能

欲輕鬆評估試製品…

快捷測量

可針對取得的 3D 形狀,以任意截面執行輪廓測量。 它搭載了段差、寬度、角度、截面積等等豐富的量測功能。



填入資料很耗時…

記錄功能

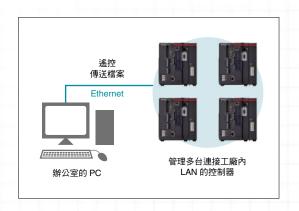
只要點一下即可將量測結果儲存至控制器內部。可將每一批的量測結果儲存為 CSV 檔,使用 PC 等裝置簡易地轉換為報表。



量測無法順利執行…

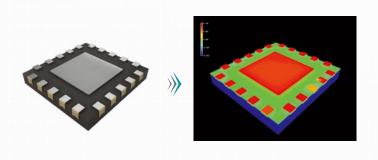
遠端操作功能

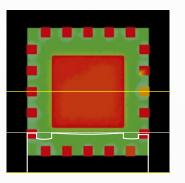
只要使用附件的軟體,即可在桌上的 PC 取得遠處的控制器量測結果或變更設定。



表面安裝零件的端子高度測量

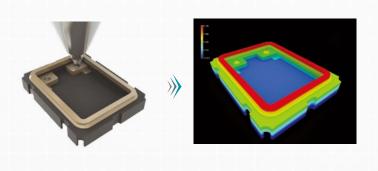
由於實現了寬廣的動態量程,即使同時存在端子部(反射光大)與陶瓷封裝(反射光小),仍可穩定量測。

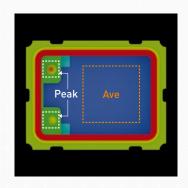




精密接著劑的高度、體積測量

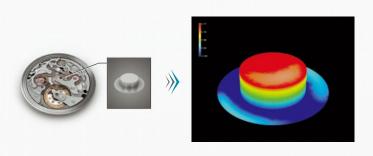
可量測剛塗布完的接著劑高度與體積。採用白光干涉原理,實現了 µm 等級的高精度量測。

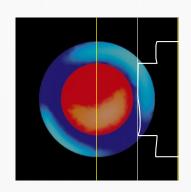




精密加工品的尺寸、平坦度測量

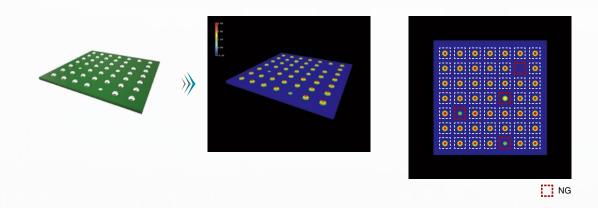
同時量測精密沖壓零件的高度、平坦度與節距等各種尺寸。由於採用高速取樣,故可實現嵌入至生產設備的全數檢查。





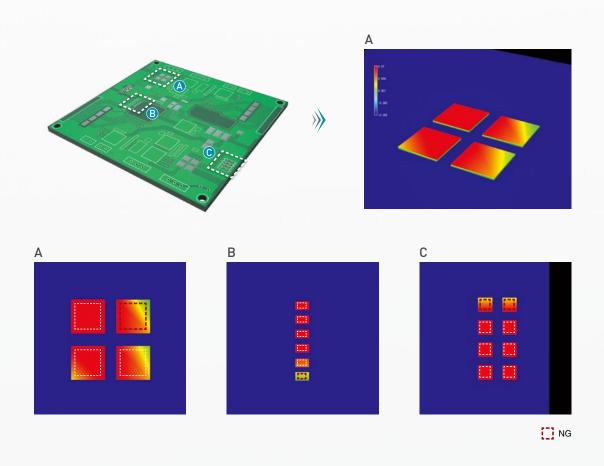
BGA 的錫球高度測量

使用多點高度測量工具,即可輕鬆量測多個 BGA。不只可量測各錫球的峰值,連面積與體積也可瞬間量測。



印刷電路板的印刷部位厚度測量

對超出 10 mm 量測區域的工件有效的是多次拍攝。不必切換程式,即可各自以不同的條件量測多個部位。





感測頭 WI-001/004/010



感測頭連接纜線

纜線類型	連接器 形狀	纜線長度		
		3 m	5 m	10 m
標準纜線	直型	WI-C3	WI-C5	WI-C10
	L型	WI-C3L	WI-C5L	WI-C10L
耐彎曲 纜線	直型	WI-C3R	WI-C5R	WI-C10R



選購配件





SD 卡 (工業規格) CA-SD16G (16 GB) CA-SD4G (4 GB) CA-SD1G (1 GB)



通訊連接線轉換連接器 9 針用 OP-26486 25 針用 OP-26485 9 針 SYSMAC 用 OP-84384 9 針 MELSEC 用 OP-86930



USB 纜線 OP-66844



RS-232C 通訊纜線 OP-26487 (2.5 m)



乙太網路纜線 **OP-66843**(3 m)



擴充 I/O 連接線 OP-51657(3 m)

塊規 OP-88165



感測頭



型 號		WI-001	WI-004	WI-010
參考距離		18 mm		
导测数图	Z	1.4 mm(標準模式), 0.7 mm(高速模式)		
量測範圍	XY	1 × 1 mm	4 × 4 mm	10 × 10 mm
最小檢測區域		4 × 4 μm	15 × 15 μm	40 × 40 μm
重複精度(段差)11		0.1 μm		
直線性(段差)*2		±2.8 μm($\pm 0.2\%$ of F.S. , F.S.=1.4 mm , $+20$	至 +30℃)
量測用光源		紅外 SLD		
	中心波長	830 nm		
	雷射分類(IEC60825-1)	等級 3R		
	輸出	3.6 mW		
引導用光源		紅光半導體雷射		
	波長	660 nm		
	雷射分類(IEC60825-1)	第1類		
	輸出	0.15 mW		
取樣週期	內部觸發	133 ms(高速模式),266 ms(標準模式)		
	外部觸發 3	最快 266 ms(高速模式) [,] 最快 532 ms(標準模式)		
環境抗耐性	環境光照	白熾燈、螢光燈 5000 lux 以下		
	環境溫度	0 至 +35℃		
	相對濕度	20 至 85%RH(無凝結)		
重量			約 3000 g	

- FDA (CDRH) 的雷射分類是基於 IEC60825-1 並根據 Laser Notice No.50 的要求而實施的。 高度(從咸測頭基準面到量測工件的距離)的解析度為 1 μm ⁽⁻¹⁾。 *1 使用 KEYENCE 標準目標物,並量測 2 個矩形區域 ⁽⁻⁵⁾ 的平均段差 30 秒時之 σ 值(關閉自動修復時,且拍攝時序為精確度優先時)。 *2 使用 KEYENCE 標準目標物,並量測 2 個矩形區域 ⁽⁻⁵⁾ 的平均段差時的值(關閉自動修復時,且拍攝時序為精確度優先時)。
- *3 拍攝時的工件停止時間為高速模式 120 ms,標準模式 240 ms。
- *4 使用 KEYENCE 標生目標物,並量測單一矩形區域 *5 的平均高度 30 秒時之 ±3 σ 值(關閉自動修復時)。 *5 矩形尺寸為 WI-001: 0.3 × 0.9 mm,WI-004: 1.1 × 3.7 mm,WI-010: 3 × 9 mm。

控制器

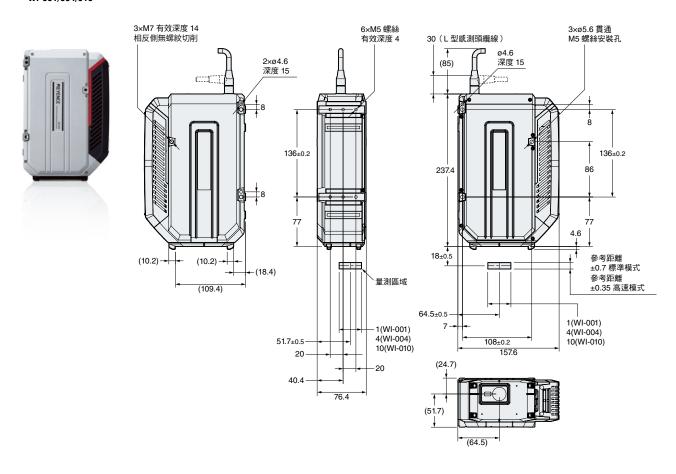
型 號		WI-5000		
感測頭連接台數		1台		
設定登錄數		SD 卡 1、SD 卡 2 各可儲存 1000 個(視 SD 卡容量和設定內容而定),支援外部切換		
量測工具數		100 個 / 設定(其中 20 個為位置偏移補正用)		
	高度	高度測量、段差測量、多點高度測量(固定配置)、多點高度測量(自由配置)、輪廓測量、連續高度測量		
量測模式	圖像尺寸測量	距離測量、寬度測量、直線檢測、角度測量、圓檢測、點檢測		
	輔助功能	數值計算、圖像範圍生成、直線顯示、圓顯示、點顯示、刻度線顯示		
	控制輸入	20 點(輸入端子台 5 點,平行 I/O 15 點)		
	控制輸出	• 28 點(輸出端子台 6 點,平行 I/O 22 點) • 光 MOSFET" ¹		
	RS-232C	數值輸出及控制輸入 / 輸出(無法與使用 RS-232C 連接埠的 PLC 連接同時使用)		
介面	PLC 連接	透過 Ethernet 連接埠或 RS-232C 連接埠進行數值輸出和控制輸入 / 輸出(無法與 EtherNet/IP™ 同時使用。 使用 RS-232C 連接埠時,無法與 RS-232C 無協議通訊同時使用)		
	Ethernet	 數值輸出及控制輸入/輸出 與 KEY/ENCE 製 PC 應用程式軟體連接後,除上述功能外,還可進行包含上傳與下載檢查設定、各種模擬、圖像資料在內的各種資料之收發、遠程連接 支援 FTP 客戶端、伺服器功能,支援 VNC 伺服器功能(電腦以外的客戶端僅支援顯示器畫面顯示)、BOOTP 功能 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 		
	USB	 與 KEYENCE 製 PC 應用程式軟體連接後,除數值輸出、控制輸入/輸出外,還可進行包含上傳與下載檢查設定、各種模擬、圖像資料在內的各種資料之收發、遠程連接 USB2.0專用 		
	EtherNet/IP™	 使用 Ethernet 連接埠進行數值輸入/輸出及控制輸入/輸出(無法與 PLC 連接同時使用) 支援周期性通訊(最多 1436 位元組),支援訊息通訊 最大連接數 32 遵循符合性測試 CT12 版 		
	滑鼠	使用選購配件的專用滑鼠(控制器隨附),即可進行各種選單操作		
	USB HDD	連接專用 USB 連接埠(符合 USB3.0、支援匯流排電源: 額定輸出 900 mA)至 HDD(最大 2 TB)後,即可輸出包含圖像資料在內之各種資料		
	顯示器輸出	類比 RGB 輸出 XGA 1024 × 768(24 bit 彩色,60 Hz)		
最小顯示單位		0.1 μm \ 0.001° \ 0.0001 mm ² \ 0.00001 mm ³		
顯示語言		支援中文(繁體)/中文(簡體)/日文/英文/韓文切換		
額定	電源電壓	24 VDC±10%		
	最大消耗電流	2.7 A		
1四 (女士・アルル	環境溫度	0 至 +45℃ (DIN 軌安裝) /0 至 +40℃ (底部安裝)		
景境抗耐性	40番12月広	35 至 85%RH (無凝結)		
-9K-5C37 61103 1±	相對濕度	33 主 63 % 日 (無凝和)		

^{*1} 支援 NPN 輸入設備的 + 共用連接、支援 PNP 輸入設備的 - 共用連接皆可。

重田古迦

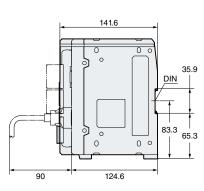
学 用又未		
型號	WI-S1	
XY 載物台移動量	X 軸 : 75 mm,Y 軸 : 50 mm	
XY 載物台傾斜角度	±2 度	
Z軸載物台移動量	粗調節輪: 64 mm,細調節輪: 2.0 mm	
外形尺寸(不含可動部)	寬度 231 × 高度 408 × 深度 360 mm	
重量	約 10 kg	

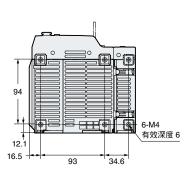
感測頭 WI-001/004/010

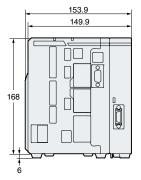


控制器 WI-5000



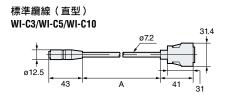




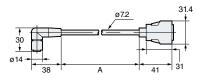


感測頭連接纜線

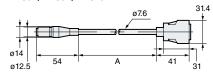
纜線長度(A=3 m/5 m/10 m)



標準纜線(L型) WI-C3L/WI-C5L/WI-C10L

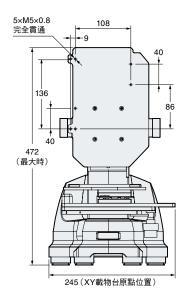


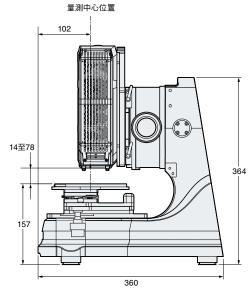
耐彎曲纜線(直型) WI-C3R/WI-C5R/WI-C10R



 專用支架
 單位:mm

 WI-S1
 量測中心位置





提供從「點」到「面」的完整產品陣容

因應場合,為您提供最佳的方案

1D 位移計

LK-G5000 系列

兼具速度、精度,擁有可適應各種目標物的因應能力,乃雷射位移計 應有的規格。在各方面均以世界最佳為目標,集結了尖端技術。



2D 位移計

LJ-V7000 系列

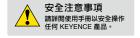
講究「線上」的形狀量測,實現了 64,000 拍攝 / 秒。 採用藍光雷射的 2D 雷射位移計可提供超穩定且高精度的輪廓測量。







WWW.keyence.com.tw E-mail: info@keyence.com.tw



產品最新發行狀況,請洽詢離您最近的 KEYENCE 據點

KEYENCE TAIWAN CO., LTD. 台灣基

台灣基恩斯股份有限公司

總部 104 台北市中山區南京東路三段168號8樓之1

新竹服務處 電話: +886-3-668-6270 傳真: +886-3-668-6737

台中服務處 電話: +886-4-2251-6602 傳真: +886-4-2251-0031

高雄服務處 電話: +886-7-333-2829 傳真: +886-7-333-2919